

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年9月29日 (29.09.2005)

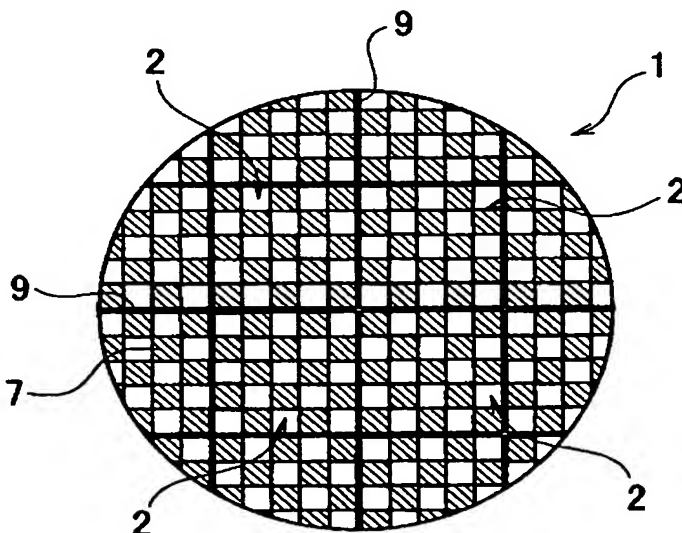
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/089901 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B01D 39/20, C04B 37/00, F01N 3/02
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/005208
- (22) 国際出願日: 2005年3月23日 (23.03.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-085529 2004年3月23日 (23.03.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本碍子株式会社 (NGK INSULATORS, LTD.) [JP/JP]; 〒4678530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 Aichi (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 梶川 直 (MA-SUKAWA, Naoshi) [JP/JP]; 〒4678530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社内 Aichi (JP). 市川 周一 (ICHIKAWA, Shuichi) [JP/JP]; 〒4678530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社内 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 渡邊 一平 (WATANABE, Kazuhira); 〒1110053 東京都台東区浅草橋3丁目20番18号 第8菊星タワービル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: HONEYCOMB STRUCTURE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(54) 発明の名称: ハニカム構造体及びその製造方法



(57) Abstract: Cracks produced when a catalyst is baked to a honeycomb structure are suppressed. In the honeycomb structure (1), a plurality of cells (5) partitioned by porous partition walls to serve fluid channels and a plurality of honeycomb segments (2) are bonded through a bonding material principally comprising a ceramic. Three point bending strength of a bonding layer (9) formed of the bonding material is set at 5 MPa or above, and shearing strength at the bonding part including the bonding layer (9) and the outer wall sandwiching it is set at 1 MPa or above.

(57) 要約: ハニカム構造体に対して、触媒の焼き付けを行う際のクラックの発生を抑制する。ハニカム構造体1は、多孔質の隔壁によって仕切られた流体の流路となる複数のセル5及び外壁を有したハニカムセグメント2の複数セラミックスを主成分とする接合材によって接合されている。接合材によって形成された接合層9の3点曲げ強度を5MPa以上とし、かつ接合層9とこれを挟んだ外壁とを含む接合部の

剪断強度を1MPa以上とする。